

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2026-048

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以下简称“本项目”或“项目”，最终名称以项目备案文件为准）；
- 实施主体：**苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”、“子公司”）。晶禧半导体系北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”、“公司”）的全资子公司；
- 投资金额：**项目预计投资总额不超过人民币 63,000 万元。（含厂房装修改造、设备购买等，具体以实际投资金额为准）；
- 资金来源：**包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；
- 审批程序：**本次投资事项已经公司于 2026 年 7 月 28 日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次投资事项尚需政府主管部门备案或审批。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
- 风险提示：**

（一）市场需求波动与竞争加剧风险

本次投资系公司及子公司基于战略发展、市场环境及行业发展趋势作出的决策。晶禧半导体主要从事先进激光隐形切割加工服务，下游客户主要为光模块厂商和芯片制造商。随着市场环境变化及市场参与者增加，若同行业公司扩大产能、跨界主体进入，或出现新技术、新产品替代，可能导致市场需求波动、市场竞争加剧，最终实际实施与生产情况具有不确定性，可能存在未能达到预期目标的风险。

（二）资金风险

本次投资资金来源包括自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。若未来宏观经济、行业政策、市场环境或公司及子公司经营情况发生不利变化，或其他项目资金需求增加，可能导致自有资金储备不足、融资渠道收紧或融资成本上升，从而影响本项目建设进度，甚至导致项目方案调整、暂停或终止，并可能对公司及子公司财务状况产生不利影响。

（三）财务风险

本项目实施后，公司及子公司固定资产及相关折旧、摊销费用预计将有所增加。若项目未能如期投产、产能释放不及预期，或投产后未能实现预期收益，新增折旧、摊销及相关成本可能对公司及子公司经营业绩产生不利影响。

（四）项目建设及扩产管理风险

本项目的实施尚需办理项目备案、环境影响评价等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。本项目实施过程中，可能因厂房改造、设备采购、人员招聘及培训、相关手续办理或其他不可抗力因素，导致项目建设进度延后、投资成本增加或产能释放不及预期。项目建成投产后，生产规模的扩大将对公司及子公司的市场开拓、运营管理、质量控制及人才储备等提出更高要求。如公司及

子公司相关管理能力未能及时适应业务规模扩张，可能对项目运营效率及经营业绩产生不利影响。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》。子公司晶禧半导体拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），项目总投资额不超过 6.3 亿元，其中购买设备金额预计不超过 6 亿元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

本项目涉及的投资规模等均为初步规划或预计数据，实际实施后，公司将根据具体方案充分论证，并及时履行相应的决策程序，依法合规推进实施。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☒投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）
投资金额	☒已确定，具体金额：总投资规模预计不超过人民币 6.3 亿元，其中购买设备金额预计不超过 6 亿元 ☐尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☐募集资金

	☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☒ 其他：其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司晶禧半导体将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会及专门委员会审议情况

本次对外投资已经公司于 2026 年 7 月 28 日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司全资子公司晶禧半导体拟在江苏省苏州市相城区投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名，最终名称以项目备案文件为准）。

本项目拟采用厂房租赁方式，通过对所租厂房实施无尘室及生产配套设施的适应性改造，以满足生产需求。项目核心聚焦先进激光隐形切割加工服务，项目全面建成后，主要切割加工规格 8/12 英寸硅光芯片、硅陪条，主要下游客户为光模块厂商和芯片制造商，可为客户提供半导体晶圆高精度隐形切割（分割）、开槽、分选等专业业务。

本项目预计于 2027 年第一季度完成生产线建设并逐步投产。上述建设内容及实施进度均为现阶段规划，最终以项目备案、审批及实际建设运营情况为准。

（二）投资项目具体信息

1、项目基本情况

项目名称：先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）

项目投资建设主体：苏州晶禧半导体科技有限公司

项目位置：江苏省苏州市相城区

项目投资金额：项目预计投资总额不超过人民币 6.3 亿元。（含厂房装修改造、设备购买等），其中购买设备金额预计不超过 6 亿元

资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整

预计建设周期：预计于 2027 年第一季度完成生产线建设并逐步投产

具体建设内容：项目以高端激光隐形切割工艺为核心发展主线，专注布局先进半导体精密加工配套服务。项目建成投产后，可实现 8 英寸、12 英寸硅光晶圆及硅陪条全规格加工产能覆盖，下游核心服务群体涵盖光模块企业与半导体芯片设计制造厂商，一站式提供晶圆高精度隐形切割、晶圆减薄、芯片分选检测等全流程专业化精密加工解决方案。

2、项目目前进展情况

目前处于前期筹备阶段。本次投资项目经董事会及股东会审议通过后，公司子公司晶禧半导体将尽快推进项目落地事宜。

（三）出资方式及相关情况

本次拟对外投资建设项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

（四）项目可行性分析

1、顺应国家集成电路产业政策，助力半导体产业链发展

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。在 2026 年的《政府工作报告》中，集成电路产业更是被列为重点打造的新兴支柱产业之首。

集成电路制造是一个由数百道精密工序组成的系统工程，主要包含设计、晶圆制造和封装测试三大环节，其中晶圆切割及分割工序是半导体制造流程中连接晶圆制造环节与封装测试环节的关键工序，其加工质量直接影响芯片良率、可靠性以及后续封装的一致性。本项目定位于集成电路产业核心配套领域，聚焦先进激光隐形切割加工服务，完全契合国家产业布局导向。

2、满足持续增长的市场需求，锁定优质客户资源

当前，AI 算力与高速光通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临稳步扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.8% 的良率水平和国内稀缺的硅光晶圆激光隐形切割量产能力，已建立技术与客户双重壁垒。面对下游需求的突然放量，晶禧半导体现有产能已不足以支撑订单交付。在这一关键行业发展期，及时扩大产能既是巩固先发优势、抓住市场机遇的战略选择，也是保障客户订单交付、维持业务持续增长的现实需要。

国内头部光通信、算力芯片企业均存在激光隐形切割加工需求，充足产能是进入客户核心供应链、获取长期定点订单的硬性门槛。本项目落地后，规模化、标准化产线可满足客户批量、稳定、持续性加工要求，推动与核心客户建立长期

稳定的框架合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆激光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略规划，提升核心竞争力。

3、完善九州一轨半导体产业链布局，落实多元化发展战略

国内城市轨道交通行业由高速建设阶段转向存量运维阶段，新增线路规划增速放缓，传统减振业务增长空间受限。本次项目顺利实施后，可以优化九州一轨的收入结构，提升公司整体经营稳定性与抗风险能力，打开公司长期成长空间，契合“提质增效重回报”发展要求，保障全体股东长期收益。

同时随着本项目的实施，九州一轨可依托晶禧半导体的精密加工能力，持续推动相关核心器件的定制化开发与性能迭代，为声纹数字化监测系统从底层硬件到上层应用的全链路优化提供坚实工艺基础，进一步夯实九州一轨在人工智能与高端装备制造融合领域的先发布局，增强核心供应链的自主可控能力。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资事项的资金来源包括子公司自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本项目实施后将有效优化公司收入结构，提升整体经营稳定性与抗风险能力，公司将结合轨道交通及声纹数字化监测业务的研发需求，进一步探索发挥晶禧半导体精密加工能力的协同作用。本次投资符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）市场需求波动与竞争加剧风险

本次投资系公司及子公司基于战略发展、市场环境及行业发展趋势作出的决策。晶禧半导体主要从事先进激光隐形切割加工服务，下游客户主要为光模块厂商和芯片制造商。随着市场环境变化及市场参与者增加，若同行业公司扩大产能、跨界主体进入，或出现新技术、新产品替代，可能导致市场需求波动、市场竞争

加剧，最终实际实施与生产情况具有不确定性，可能存在未能达到预期目标的风险。

（二）资金风险

本次投资资金来源包括自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。若未来宏观经济、行业政策、市场环境或公司及子公司经营情况发生不利变化，或其他项目资金需求增加，可能导致自有资金储备不足、融资渠道收紧或融资成本上升，从而影响本项目建设进度，甚至导致项目方案调整、暂停或终止，并可能对公司及子公司财务状况产生不利影响。

（三）财务风险

本项目实施后，公司及子公司固定资产及相关折旧、摊销费用预计将有所增加。若项目未能如期投产、产能释放不及预期，或投产后未能实现预期收益，新增折旧、摊销及相关成本可能对公司及子公司经营业绩产生不利影响。

（四）项目建设及扩产管理风险

本项目的实施尚需办理项目备案、环境影响评价等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。本项目实施过程中，可能因厂房改造、设备采购、人员招聘及培训、相关手续办理或其他不可抗力因素，导致项目建设进度延后、投资成本增加或产能释放不及预期。项目建成投产后，生产规模的扩大将对公司及子公司的市场开拓、运营管理、质量控制及人才储备等提出更高要求。如公司及子公司相关管理能力未能及时适应业务规模扩张，可能对项目运营效率及经营业绩产生不利影响。

公司及子公司将加强项目建设及运营管理，合理安排资金投入和建设进度，但项目实际实施进度及经济效益仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日